

# Kupferbad SLOTOCOUP BV 50

Das Kupferbad SLOTOCOUP BV 50 wird bei der Produktion von HDI-Leiterplatten eingesetzt, um in einem einzigen Verfahrensschritt

- Blind Microvias mit Kupfer zu füllen,
- das Leiterbild aufzubauen,
- Durchgangsbohrungen zu verkufern.

Die aus dem Kupferbad SLOTOCOUP BV 50 abgeschiedenen Schichten sind hochglänzend. Die erreichbare Einebnung ist außergewöhnlich. Streufähigkeit und Metallverteilung sind exzellent.

Das Kupferbad SLOTOCOUP BV 50 wurde speziell für den Einsatz in vertikalen Durchlaufanlagen, die mit Kupferanoden ausgestattet sind, entwickelt.

Die Metallverteilung lässt sich durch Steuerung der Stromdichte und Elektrolyt-zusammensetzung an die geometrischen Bedingungen der zu beschichtenden Leiterplatten anpassen.

Das Kupferbad SLOTOCOUP BV 50 wird mit drei Flüssigzusätzen betrieben.

Die Angaben in der Gebrauchsanleitung basieren auf unseren Labor- und Praxiserfahrungen. Da Ergänzungsmengen und Eingriffsgrenzen in Abhängigkeit von Materialart und -geometrie, deren Anwendung und der Anlagentechnik ggf. von den Angaben in der Gebrauchsanleitung abweichen können, sind diese Angaben nicht bindend.

## Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfältig zu lesen und alle die Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die Gefahrenhinweise auf den Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Produkte kann ebenfalls den Gebindeetiketten oder dem entsprechenden Qualitätszertifikat (QA03) entnommen werden.

Die aktuelle IMDS-Nummer für die aus dem Verfahren abgeschiedene Schicht kann im Internet unter [www.schloetter.de/downloads](http://www.schloetter.de/downloads) eingesehen werden.

Für die Lagerung von chemischen Produkten ist die TRGS 510 maßgebend.

